

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

环旭电子股份有限公司

2026 年第二季度投资人线上说明会活动记录

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他
时间	2026 年 7 月 28 日
地点	线上会议（进门财经网络研讨会）
上市公司 参会人员	魏镇炎（总经理）、许远忠（子公司光创联 CEO）、史金鹏（董事会秘书）、吴新宇（财务长）
参会机构名称	瑞银证券、麦格理集团、摩根大通、锦成盛资管、TOPAZ FAMILY、野村国际、花旗银行、华泰证券、朱雀基金、摩根士丹利、华创证券、国海富兰克林、国海证券、山西证券、永丰证券、交银施罗德、中量基金
嘉宾简报及投资者提问	一、公司2026年第二季度经营业绩情况（财务长吴新宇先生） 【经营情况概述】 2026年上半年度营业收入为273.4亿元，较去年同期同比增长0.5%。2026年第二季度营业收入为139.9亿元，较第一季度环比增长4.8%，较去年同期同比增长3.1%，略低于前期业绩指引。 营业收入同比增长主要得益于AI智能卡出货量成长、新产品量产，以及因供应紧缺造成重要物料涨价而带来的产品售价提升，但人民币汇率升值抵减了部分增长。第二季度营业利润率为3.2%，较去年同期的2.6%，同比增长0.6个百分点。 第二季归母净利润为4.0亿元，归母净利率为2.9%，较去年同期的2.2%，同比增长0.7个百分点。扣非后归母净利润为3.8亿元。上半年度归属于上市公司股东的净利率为3.0%，较去年同期的2.3%，同比增长0.7个百分点。 2026年上半年每股收益为人民币0.35元/股，2025年上半年每股收益为人民币0.29元/

	股，同比增长20.69%。受净利润、净资产同比增长的原因，ROE、ROA、EBITDA、EPS同比增长。 【营业收入】 2026年上半年度营业收入为273.4 亿元，综合物料涨价、新产品量产及AI智能卡的成长，扣除人民币汇率的负面影响，较去年同期同比增长0.5%。 第二季度实现营业收入为139.9亿元，较去年同期的135.7亿元，同比增长3.1%，相较于第一季度133.5亿元，环比增长4.8%。 （1） 通讯类产品实现营收41.9亿元，同比减少4.3%；主因市场竞争以及WiFi模组物料采购成本下降带动产品降价。 （2） 消费电子类产品实现营收40.2亿元，同比减少2.4%；主因穿戴产品同比出货量减少，营业收入同比减少。 （3） 工业类产品实现营收22.2亿元，同比增长15.1%；主因主要客户需求增长带来的收入成长所致。 （4） 云端及存储类产品实现营收23.0亿元，同比增长52.9%；主要得益于AI智能卡出货量成长，及受存储材料价格因紧缺大幅上涨影响所致。 （5） 汽车电子类产品实现营收8.9亿元，同比减少31.8%，主因公司合并报表范围变化所致。 （6） 医疗类产品份额较小，实现营收1.2亿元，同比增长18.2%。 【营业毛利及营业毛利率】 第二季度实现营业毛利为11.5亿元，同比减少16.7%，相较于第一季度环比减少8.8%。第二季度营业毛利率为8.2%，较去年同期10.2%，同比减少2.0个百分点，相较于第一季的9.5%，环比减少1.3个百分点。 其中： 云端及存储类产品毛利同比减少25.9%，毛利率同比减少11.9个百分点，主系去年同期存在因客户对前期材料价格差异的一次性补偿带来的有利影响，同时当期存储物料成本大幅上涨导致本期毛利及毛利率下降所致。 通讯类产品随市场份额的同业竞争所致营收下滑，毛利同比减少0.8%，因客户产品结构的变化影响，毛利率同比增长0.2个百分点。 消费电子类产品受营收下降、产品组合变动及汇率变动等多个因素影响，导致毛利同比减少24.0%，毛利率同比减少1.9个百分点。
--	--

	汽车电子类产品毛利同比减少92.3%，毛利率同比减少10.5个百分点，主系合并报表范围的影响。 工业类产品毛利同比增长14.5%，毛利率基本与去年持平为13.6%。 【现金流量】 公司2026年上半年现金流量为净流出19亿，其中： 经营活动产生的现金流2026年上半年度为净流出人民币4.3亿，主因市场材料供应紧张，公司提前备料，加上本季营收增长集中于后半季，而主要客户账期为45至60天，新增销售对应的应收账款尚未到期回收，导致销售增长与现金回款存在阶段性时间差。 投资活动产生的现金流2026年上半年度为净流出8.9亿，较去年同期流出增加人民币3.9亿，主系本期收购境内公司股权及外汇避险操作产生的已实现收益较上年同期减少所致。 公司上半年固定资产投入美金1.06亿，主要为生产设备上的投资。 筹资活动产生的现金流2026年上半年度为净流出5.8亿，较去年同期流出增加人民币3.1亿元，主系本期向股东发放现金股利同比增长所致。 【营运情况】 因材料供货紧张公司提前备料所致，现金周转天数较去年同期增加6天，至49天，整体仍处于健康水平。 2026年第二季度末公司总资产、净资产有所增长，有息负债因可转换债券转股及赎回原因，较去年年底减少29.2%，资产负债率因可转换债券转股及赎回原因，本期较去年年底减少3.8个百分点。 2026年上半年度总资产收益率2.2%，加权平均净资产收益率为3.7%，每股收益为0.35元/股 【经营目标】 受部分业务关键物料采购价格涨幅较大影响，预计第三季度单季营业收入同比增长15%-20%，第三季度单季营业利润率环比增长0.5个百分点左右。 二、光通信业务进展（光创联CEO许远忠先生） 1、成都扩产进度、规划以及客户验证进展 目前成都具备了40K/M 800G硅光引擎产能，800G OE产品正在进行最终工艺流程及可靠性验证。厂房扩建上，公司在原有2,000m²厂房基础上扩建了3,400m²，含1,800m²万级洁净室，目标是新增100K/月产能。目前设备陆续到货并调试，预计到10月OE产能会达到120K/月。
--	--

	此外，公司将视客户需求及项目进展，规划进一步扩充3,400m²生产场地，在2027年Q1将OE产能扩充至220K/M，Q2扩充至320K/M。 当前，公司正积极争取物料，以通过渠道市场先实现OE的量产供货。在北美重要客户上，估计今年Q4能够量产出货，并在2027Q1取得200K/M量级的订单。 2、越南的扩产进度及规划 今年6月，部分设备开始到货并安装调试，并形成了10K/M的OE产能，由于部分设备的交货周期延长，预估OE和OT的部分在今年10月可以扩产至100K/M产能，相关自动化组装线预计10月完成，DCA的设备也会在Q4陆续交付，相应公司将于Q4邀请重要客户验厂。公司未来将视客户需求及项目进展，进一步于2027Q2将OE和OT产能扩充至200K/M。 3、NPO/CPO布局 (1) 策略协同。在NPO/CPO的布局上，集团内部会协同资源，从客户的导入到共同开发，为客户提供端到端的解决方案，ASE将聚焦于先进封装和chiplet环节，公司将重点聚焦光学的解决方案能力。 (2) 产品策略。D-FAU的耦合及ELSFP将作为公司在NPO/CPO应用中的重点产品，成都研发中心进行开发，NPI及量产会按照客户对应区域及要求，成都及越南分别负责国内及海外客户。 (3) 产品开发。D-FAU，将已封测chiplet搭建光学fan-out方案，解决定制化的connector的active alignment和attachment，完成最终optical engine的测试与出货。ELSFP：产品已进入设计验证阶段后期，方案可兼容多家芯片资源，光学耦合效率以及散热管理等关键参数已完成进一步的优化。 (4) 量产规划。在D-FAU和ELSFP上，公司已与多家头部客户开展合作，预估NPO市场放量将早于CPO，公司有望在2027H2进入ELSFP的小批量或批量生产，成都暂定的一期产能规划为100K/M，后面会视项目进展情况进一步扩展调整。同步，公司已启动越南新工厂建设，预估于2028H1具备量产能力。 【Q&A环节】 【问题】公司此前光模块业务进展略有延迟，在ELSFP的规划上如何保障如期进行？核心物料如何解决？ 【回答】以光互联技术发展的技术趋势来看，从光模块到CPO，中间会有NPO的过渡和应用。在NPO以及CPO的发展过程中，ELSFP是一个重要的产品环节，并需要高度的光学耦合效率
--	---

	以及热管理能力。以光创联的业务定位及技术积累，ELSFP是光创联目前最有竞争优势的产品之一，也是公司下一步扩产的重点。 为确保ELSFP业务如期达成，公司将实施以下战略措施： 1）在制度层面，建立专项考核机制，将关键节点达成率纳入核心团队绩效。 2）在执行层面，组建跨部门攻坚小组，实行周度复盘与风险预警，确保研发、供应链与销售端高效协同。 3）在供应链层面，公司将深化与核心芯片供应商的战略合作，通过联合研发与长协锁定，构建多元化供应体系，从源头保障关键物料的稳定性与成本优势。公司将利用集团资源及自身光学封装、耦合的技术积累，积极推进业务，目前已与国内外多家CW供应商建立合作关系，后续会选择2-3家形成战略合作伙伴关系达成长周期产能锁定，确保核心物料的优先供应。 同时，厂房/设备/工艺协同升级，公司持续优化自研自动化产线布局，切实保障产品良率与交付效率。 【问题】公司PDU业务此前是匹配TSMC SOW制程所开发的，该制程目前量产时间有所延期，那公司是否有进一步在这个业务上匹配目前客户所需的制程并拓展新的客户？公司是否有相应的人员技术储备？ 【回答】目前公司已与ASE以及功率芯片的合作伙伴共同开发PDU lite产品，以适配客户目前的需求，计划会在8月进行首次送样，并计划于2027年下半年开始小批量，2028年有望进行规模化量产。目前已规划的NPI产线及配套capex预估在1,300万美元左右。从人员储备上，公司针对该业务领域，持续招聘技术人员，以满足业务开展的需求。 【问题】公司Q2营业收入略低于指引，具体是什么业务影响造成的收入不及此前的经营目标？ 【回答】公司Q2收入略不及预期，是一个综合性的影响，具体包括了以下几个因素： 1、人民币升值带来的汇率影响。与去年同期相比，人民币兑美元升值接近5%。由于公司大部分收入以美元或欧元计价，人民币报表上汇率因素对收入增长率带来一定负面影响。 2、原材料价格上涨带来的收入提升。部分关键原材料价格较去年同期明显上升，其存储相关物料受供需紧张影响涨幅尤为显著。此外IC价格亦较去年有所提高。在售价与材料价值同步上升的情况下，对收入规模产生一定正面贡献。 3、物料短缺导致部分收入递延。持续性的供应链紧张及部分关键零组件短缺，导致部分产品出货时程延后，影响了部分云端存储及子公司AFG的相关业务。相关收入延后金额约为
--	---

	4,000万美元。 【问题】公司Q3收入增长较多，但营业利润同比下滑，物料涨价对收入及营业利润的影响情况是怎样的？ 【回答】公司第三季度业务目标中的营收部分，考虑了原材料价格，尤其是存储类材料价格的持续上升，而如果不考虑汇率变动因素的话，营收成长能够达到20%-25%。从实际业务产出来看，剔除原材料价格上涨因素后，预计业务增长约为高个位数百分比。原材料价格上涨，不会对公司的毛利额及营业利润额产生实质性的影响，但材料成本的上升带动的营收上升，会对营业利润率产生稀释效应。 【问题】关注到公司友商规划将SiP产能从韩国转移到越南，过程中会有产能损失，公司会不会因此获益？ 【回答】SiP业务在Q3是传统旺季，若友商在此过程中影响其实际产能，对公司来说会是一个机会。公司在服务大客户上长期较为积极，多年来在份额上也保持相对优势，但为了保持优势有时候也会有降价并对利润率产生影响。 【问题】公司在成都后续的扩产是否有确定的客户？ 【回答】公司的目标是头部客户，成都主要聚焦硅光光引擎的封装和制造，目前和客户沟通协调进展相对顺利，虽然因部分重点设备的交期原因有所延期，但目前已进入量产工艺的定性及可靠性工作，希望Q4可以在重点客户上逐步起量并在明年Q1取得大幅增长。 【问题】光通信业务上自研光模块的进展是怎样的？ 【回答】公司光模块的自研开发在并购光创联前就开始做研发，并购后持续在光学和工艺上进行改进，1.6T的产品上预估在Q3-Q4时能够完成最后的设计工作，同时由于物料较为紧缺，也会根据物料的情况优化物料方案并相应调整，从公司层面上来看近期业务重点还是放在800G量产上。 【问题】公司AI加速卡业务的产能以及业务拓展的更新情况？ 【回答】今年AI加速卡业务在上半年带动了云和存储板块超过50%的营收成长，后续的成长动能将保持，即便扣除存储涨价影响，相较于去年的同比增速依然可观。从产能上来看，去年底有两条产线，今年Q2增加至四条产线，预计今年Q3增加至五条产线，并在明年上半年再增加一条产线来满足客户需求。AI加速卡的业务上，核心客户希望公司持续增加台湾地区产能，公司已经启动在台湾地区寻找新的厂房以满足客户进一步的产能扩充需求，同时公司也会考虑将其他客户的一些需求部分放在越南和墨西哥，通过和客户的协调争取将越南和墨
--	--

	西哥的产能利用起来。 【问题】 CPO的业务领域上，公司与ASE协同并于海外客户沟通时，公司的具体业务定位是什么？ 【回答】 光创联加入环旭电子后，得到了整个集团在业务上的支持。在CPO的项目上，我们与客户接洽中，客户对公司的需求主要集中在D-FAU的耦合以及ELSFP上，这两部分业务是公司未来推进的重点业务。 CPO的制程上，ASE会聚焦前端的先进封装，公司将聚焦后端的光学工艺设计及测试。在CPO量产角度上来看，FAU的多通道耦合是一个重大挑战，会带来良率的损失，此前公司业务已经涉足了多通道耦合，在32通道（16收16发）形成出货，已经有了一定的技术积累，在这方面公司目前也在形成专利技术并着手申请中。D-FAU的多通道耦合在行业内还是具有较高挑战性的，如果能较好的解决耦合工艺制程及良率等问题，相信公司能够在这方面形成较强的竞争优势。 此外，在D-FAU的耦合上，公司还积累了自研耦合设备的能力，结合公司的工艺制程和算法开发自动化的耦合设备，相较于行业内其他厂商，这将是公司特有的竞争优势。 【问题】 FAU的器件公司会去做吗？ 【回答】 目前还不考虑涉及FAU的制造，公司主要聚焦基于coupe的自动化耦合的光学系统设计以及工艺设计，公司将提出适合公司设计方案的FAU要求，FAU器件可以外发制造。 【问题】 CPO业务后续的开展模式是怎样的，是来料加工的模式，还是公司出模组？毛利率水平是怎样的？公司会出售自动化耦合设备吗？ 【回答】 主要看客户的需求，公司在开展模式上保持开放态度。在毛利率水平上，目前看到整个行业在CPO上，在先进封装和光学封装的附加值会比较高。从公司定位来看，不是光耦合设备厂商，公司还是会聚焦产品的量产实现上。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 7 月 28 日